

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2023-024

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1514号《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行不超过96,465,371股，每股发行价格为人民币57.83元。截至2020年12月28日止，本公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票17,793,527股，募集资金总额为人民币102,899.97万元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币1,468.34万元后，实际募集资金净额为人民币101,431.63万元。该募集资金已于2020年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0272号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年1月15日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入17,770.81万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17,770.81万元；（2）公司本次募集资金不含税各项发行费用合计人民币1,468.34万元，其中直接从募集资金中扣除的不含税保荐及承销费人民币1,329.00万元，剩余不含税发行费用合计人民币139.34万元业已支付；（3）直接投入募集资金项目64,646.60万元。其中2022年度公司累计使用募集资金9,493.84万元，以前年度累计已使用金额55,152.76万元，2022年度使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元，扣除累计已使用及闲置募集资金进行现

金管理金额后，募集资金余额为 36,785.03 万元，募集资金专用账户利息收入 2,938.83 万元，合计为 39,723.86 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日实际余额合计为 39,723.86 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额合计为 39,723.86 万元，其中募集资金专户余额为 39,723.86 万元，现金管理产品余额为 0.00 万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 1 月 15 日，本公司与存放募集资金的银行（中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国银行股份有限公司苏州工业园区分行开设募集资金专项账户（账号：498875522450）、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：10551301040055605）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	498875522450	10,182.98
中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	10551301040055605	29,540.88
合计		39,723.86

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计

人民币 64,646.60 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2021 年 02 月 05 日，公司第四届董事会第八次临时会议及第四届监事会第七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 17,770.81 万元。置换金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚专字[2021]230Z0181 号《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于 2022 年 2 月 22 日召开第四届董事会第十六次临时会议及第四届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限 12 个月以内风险低、安全性高，流动性好的产品，使用期限自公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	发行主体	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	理财收益 (万元)	是否 到期	期末余 额(万 元)
1	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	定期存款	10,000.00	2022 年 1 月 4 日	2022 年 7 月 3 日	174.00	是	—
2	中国银行股份有限公司苏州工业园	7 天通知存款	10,000.00	2022 年 7 月 7 日	2022 年 12 月 30 日	141.69	是	—

序号	发行主体	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	理财收益 (万元)	是否 到期	期末余 额(万 元)
	区分行							
3	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	7天通知存款	37,000.00	2021年12月1日	2022年1月28日	135.72	是	—
4	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	20,000.00	2022年2月28日	2022年8月17日	153.81	是	—
5	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	10,000.00	2022年2月28日	2022年5月19日	90.00	是	—
6	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	10,000.00	2022年5月20日	2022年11月21日	89.93	是	—
7	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	20,000.00	2022年8月18日	2022年12月26日	126.39	是	—
合计			117,000.00			911.54		—

公司理财产品均为保本理财,不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。

注:公司2022年度募集资金理财收益金额为911.54万元,与累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额1,170.57万元差异部分系活期利息收入。

(五) 募集资金使用的其他情况

2022年12月16日,公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将“集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会及独

立董事就该事项发表了明确同意意见。

报告期内，除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

晶方科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议。募集资金使用期间，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对晶方科技募集资金存放与使用情况无异议。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				101,431.63	本年度投入募集资金总额					9,493.84		
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额					64,646.60		
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目	否	101,431.63	101,431.63	101,431.63	9,493.84	64,646.60	-36,785.03	63.73%	详见注 1*	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资产品情况。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					截止 2022 年 12 月 31 日, 募集资金合计为 39,723.86 万元, 扣除尚未支付的募投项目设备尾款后结余原因对对机器设备进行差异化购置、在建工程改为共用公司现有无尘车间能力及生产管理系统依托了公司现有的 MEMS 系统。							
募集资金其他使用情况					详见本报告三、(五)募集资金使用的其他情况。							

注 1*: 截至 2022 年 12 月 31 日, 尚有部分设备正处在调试中, 即将量产。

注 2*: 2023 年 1 月 4 日, 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》经 2022 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 1 月节余募集资金已补充流动资金。